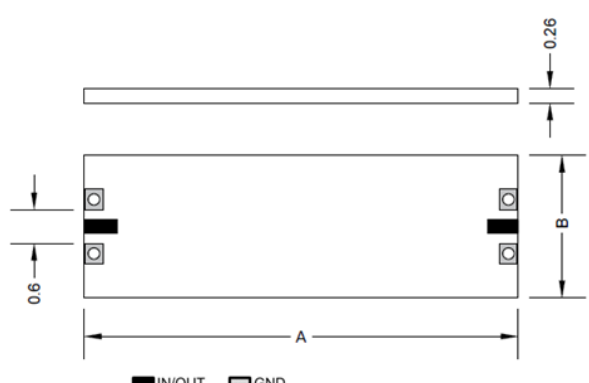


技术指标（常温+25℃）

序号	参数	最小	典型	最大	单位
1-1	产品型号	YTFBP9R3/R4-7UA			
1-2	产品尺寸	8mm*4.0mm*0.254mm			
1-3	中心频率 f0		9.3		GHz
1-4	工作频率	9.1		9.5	GHz
1-5	中心损耗		2.7	3.0	dB
1-6	带内波动		1.0	1.5	dB
1-7	回波损耗	12	15		dB
1-8	带外抑制@6.5-8.3GHz	55			dBc
	带外抑制@10.5-12GHz	40			
1-9	承受功率			33	dBm
1-10	工作温度	-55		+85	℃
1-11	存储温度	-55		+125	℃
1-12	输出安装方式	键合			

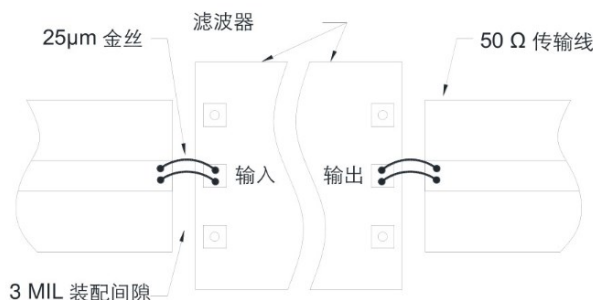
外形尺寸

2-1	外形尺寸	见下图（A、B 外形公差：±0.1mm）
		
2-2	标识尺寸	A: 8mm B: 4.0mm C: 0.254mm（图中尺寸单位为 mm，A、B 外形公差：±0.1mm）
2-3	基板材料	氧化铝 (Er=9.8)
2-4	表面处理	镀金

版本状态

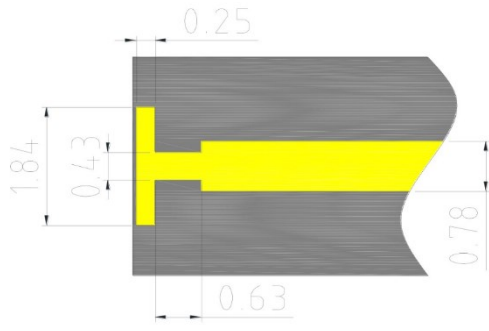
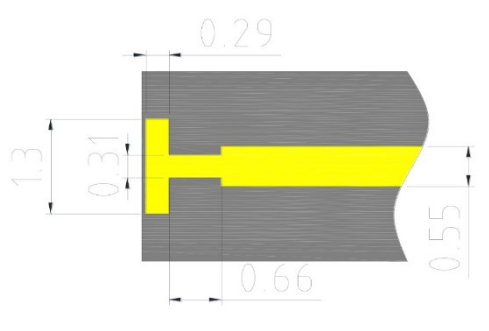
版本号	版本日期	文档状态
V1	20260317	✓

建议装配图

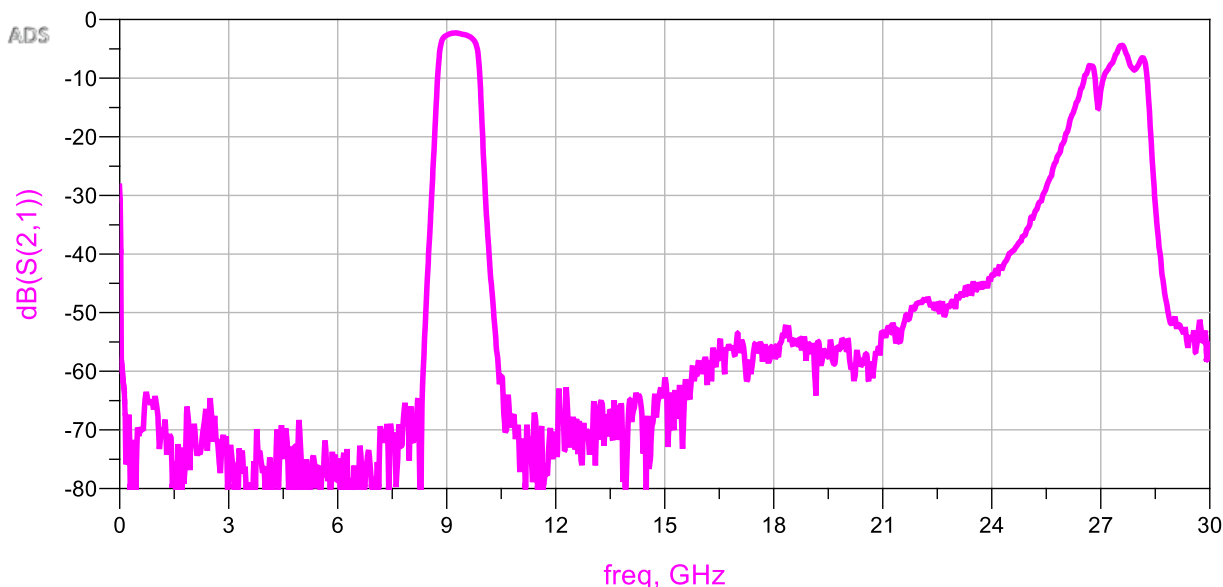


注意事项

- 1、芯片建议分腔使用，两侧距离侧壁0.2mm左右，表面距离上盖板1.75mm左右，芯片端口可互换；
- 2、芯片应安装在可伐或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载片上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 3、芯片推荐使用低应力导电胶粘接；
- 4、电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型节尺寸如下：

电路板Rogers5880，10mil厚	电路板Rogers4350，10mil厚
	
适用频率：DC-38GHz	适用频率：DC-32GHz
注：T型图形顶端基板白边50um；频率10GHz以下无需匹配	

实测曲线：



m11
freq=9.250GHz
dB(S(2,1))=-2.299
Max

m3
freq=9.500GHz
dB(S(2,1))=-2.603

m8
freq=9.100GHz
dB(S(2,1))=-2.422

m9
freq=7.360GHz
dB(S(2,1))=-68.996

m10
freq=10.50GHz
dB(S(2,1))=-60.822

